

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 17 年 11 月 4 日 (2005.11.4)

【公開番号】特開 2004-95679 (P2004-95679A)  
 【公開日】平成 16 年 3 月 25 日 (2004.3.25)  
 【年通号数】公開・登録公報 2004-012  
 【出願番号】特願 2002-251959 (P2002-251959)  
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 5 K 3/34

H 0 1 L 23/12

H 0 1 P 5/08

H 0 5 K 1/02

H 0 5 K 1/18

【F I】

H 0 5 K 3/34 5 0 1 D

H 0 1 L 23/12 3 0 1 Z

H 0 1 P 5/08 L

H 0 5 K 1/02 J

H 0 5 K 1/18 J

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 8 月 19 日 (2005.8.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

信号ラインが形成された誘電体基板上に部品を実装する部品実装方法において、  
 前記信号ラインの形状と前記部品に設けられた電極の形状とを整合させる整合用導体を、  
 前記信号ライン上に実装する段階と、  
 前記部品を前記整合用導体上に実装し、前記信号ラインと前記部品に設けられた電極と  
 を前記整合用導体を介して電氣的に接続する段階と  
 を有することを特徴とする部品実装方法。

【請求項 2】

信号ラインが形成された誘電体基板と、その誘電体基板上に実装された部品とを有する  
 電子回路において、  
 前記信号ライン上に実装されており、前記信号ラインの形状と前記部品に設けられた電  
 極の形状とを整合させる整合用導体と、  
 前記整合用導体上に実装されており、前記電極が前記信号ラインに前記整合用導体を介  
 して電氣的に接続された部品と  
 を有することを特徴とする電子回路。

【請求項 3】

前記整合用導体は、前記部品に対向する接触面の幅が前記信号ラインに対向する接触面  
 の幅よりも大きく、前記部品に対向する接触面の幅と、前記信号ラインに対向する接触面  
 の幅と、前記誘電体基板の厚みと、前記整合用導体の幅が前記部品に対向する接触面の幅  
 と同じになる高さと前記誘電体基板との間隔とに応じて、前記信号ラインと前記部品との  
 特性インピーダンスを整合させることを特徴とする請求項 2 記載の電子回路。

## 【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0002

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0002】

【従来の技術】

例えば光通信装置は、マイクロ波又はミリ波などの高周波領域の信号を扱う電子回路（以下、単に電子回路という）を含むように構成されている。このような電子回路は、数  $\text{kHz}$  ～ 数十  $\text{GHz}$  程度の広帯域特性が必要であった。

したがって、電子回路の誘電体基板上に実装する部品は、良好な広帯域特性が要求されていた。例えば特開平 4 - 278571 号公報，特開 2000 - 269383 号公報，特開 2001 - 144395 号公報，特開平 9 - 107210 号公報および特開平 4 - 67657 号公報には、誘電体基板上に実装した部品の広帯域特性を良くする技術が記載されている。